



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-2-5 はんだ付着／焊料的附着 / Adhered solder

【特徴】 余分な所にはんだが付着している状態の欠陥

【特征】 在指定以外的地方附着焊料的缺陷。

【Characteristics】 Solder is adhered on an unwanted area.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R が剥がれている部分にはんだが付着したことにより出来たもの（HAL 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 SR 剥落的部位附着焊料所引起的（HAL 工序）。

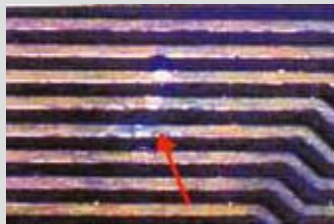
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by stripping of solder resist at the area where solder resist must cover. (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-2-6 はんだボール付着／焊珠的附着 / Solder ball adhesion

【特徴】 S R 表面などにはんだボールが付着している状態の欠陥

【特征】 在 SR 表面等附着焊珠的缺陷。

【Characteristics】 A solder ball is adhered on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】 HAL 工程の搬送中に、はんだボールが S R の表面などに圧着されて出来たもの（HAL 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 HAL 工序的输送中，SR 表面压入焊珠等所引起的（HAL 工序）。



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×